⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-5415

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)1月11日

G 05 D 23/24 G 01 K 7/18 H 05 B 3/00

Q-2117-5H A-7269-2F

... J - 8715-3K 審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

49発明の名称

発熱体と温度測定用センサとの接合方法およびその装置

②特 願 昭61-148204

実

29出 題 昭61(1986)6月26日

⑫発 明 者 小 丸

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

①出願人 株式会社東芝 ②代理人 弁理士井上 一男

明 細 嘗

1. 発明の名称

発熱体と温度測定用センサとの接合方法およびその装置

2. 特許請求の範囲

- (1) コ字形発熱体の側面に平行して中央部に有 底孔が設けられ、この有底孔の内部に接着剤を塗 布した後、温度測定用センサとしての測温抵抗体 を挿入して接着するようにしたことを特徴とする 発熱体と温度測定用センサとの接合方法。
- ② 接着剤はセラミックス系を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の発熱体と温度測定用センサとの接合方法。
- (3) 測温抵抗体は白金コイルを用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の発熱体と温度測定用センサとの接合方法。
- (3) コ字形の発熱体と、この発熱体の側面に平行して中央部に設けられる有底孔と、この有底孔の内部に接着剤を塗布して挿入することにより接合可能な温度測定用センサとしての測温抵抗体とを備えたことを特徴とする発熱体と温度測定用セ

ンサとの接合装置。

- 切 接着剤はセラミックス系を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の発熱体と温度測定用センサとの接合装置。
- ⑥ 測温抵抗体は白金コイルを用いたことを特 徴とする特許請求の戦闘第4項記載の発熱体と温 度測定用センサとの接合装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明はたとえば加熱ヘッドの先端に取付けられた発熱体としてのヒータチップにおいて、このヒータチップの発熱温度を測定するのに適した温度測定用センサの接合方法およびその装置に関する。

(従来の技術)

発熱体、たとえば加熱ヘッドの先端に取付けられたヒータチップにおいて、ヒータチップの発熱 温度を測定する場合、ヒータチップに検出センサ を接合し、温度測定および制御が行なわれている。

ところで、従来は検出センサとして熱電対をヒー タチップにろう付したり、あるいは接着剤を用い てサーミスタやサーモラベル(商品名)をヒッタ チップの側面に固定したりする方法が行なわれて いた。第5回乃至第7回はヒータチップに熱電対 をろう付する場合を示したものである。第5図に おいて、四は加熱ヘッドのの先端に取付けられる コ字形のヒータチップで、このヒッタチップ20の 先端中央部には第6図に示す貫通孔3が穿設され ている。しかして、上記ヒータチップ②に熱電対 を接合する方法は第7명(a)に示すようにヒータ チップ②の表面側から熱電対のリード級@蟾部に 取付けられている例えば鍛ろうからなる熱電対玉 ⑤を上記ヒータチップ②の貫通孔③に挿入した後、 第7図(b)に示すようにヒータチップ②の基面側 より、たとえばガスバーナ闷で上記熱電対玉匂を 髙温で加熱溶融することにより、銀ろうは貫道孔 ③内に溶着されて熱電対のリード線(4)をヒータチ ップ囚に接合するようにしていた。

しかしながら、ヒータチップ(2)と熱電対とをろ

剤を塗布して挿入することにより接合可能な測温 抵抗体とを設けて構成されるものである。

(作 用)

すなわち、本発明は上記構成とすることにより、 測量抵抗体は高度な溶接技術を必要としないで確 実に接合し得、また発熱体に対して測温抵抗体の 接合に無理がかゝらなくなって外れる心配もなく なり、コストの低減を図ることができる。

(実施例)

以下、本発明を第1図乃至第4図に示す一実施例にもとづいて説明する。第1図および第2図において、(11)は加熱ヘッド(1)の先端に取付けられる発熱体としてのコ字形と一タチップで、このヒータチップ(11)の中央部分には側面に平行して有底孔(12)が設けられている。この有底孔(12)の内径は第3図に示す測温抵抗体(13)の外径よりも僅か大きく穿設されるようになっている。

つぎに、第4回にもとづきヒータチップ(11)と 泗温抵抗体(13)との接合方法を説明する。 瀬温抵 抗体(13)はたとえば線径15μの白金コイル(14)と、 う付けする際、高温加熱により貫通孔(3) 周辺のヒータチップ(2)にひび割れを生ずる成れがあり、また段取りに手間がかゝり、かつ高度な溶接技術を必要とするものである。また、他のセンサとして俯えばサーミスタ(商品名)等をヒータチップに接着あるいは取付金具で圧接することは接合技術に困難があり、かつ取付寿命も短かく正確な温度検出が行なえないという問題を有していた。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記事情にもとづいてなされたもので、従来のろう付け方式に示す高度な溶接技術を必要とせず、しかも接合部分が外れることなく容易に接合し得るとともにコストの低減を図ることができる発熱体と温度測定用センサとの接合方法およびその装置を提供することを目的とする。

〔発明の構成〕

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記問題点を解決するために、コ字形の発熱体と、この発熱体の側面に平行して中央部 に設けられる有底孔と、この有底孔の内部に接着

この白金コイル(14)を収容するセラミックス系の容器(15)とから構成されるものである。そこで、上記ヒータチップ(11)に測温抵抗体(13)を接合する場合、ヒータチップ(11)に設けた上記有底孔(12)内にたとえばセラミックス系の接着剤(a)を塗布した後、上記測温抵抗体(13)を有底孔(12)内に挿入して埋込み、数時間放置しておくことにより接着剤(a)は硬化するため、測温抵抗体(13)とヒッタチップ(11)との接合を容易に行なうことができる。

なお、上記白金コイル(14)から成る測温抵抗体(13)は第5回に示すように電源(16)、制御部(17) および増幅器(18)を介して通電することにより発 熱し、ヒータチップ(11)に必要な温度(350℃~400℃)に加熱することができるものである。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば従来のろう 付方式に対して高度な技術を全く必要とせず、また接合部分が外れることなく確実に接合されて発 熱体を所定の温度に加熱するので信頼性を向上せ しめ得るとともにコストの低減を図ることができ るという効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

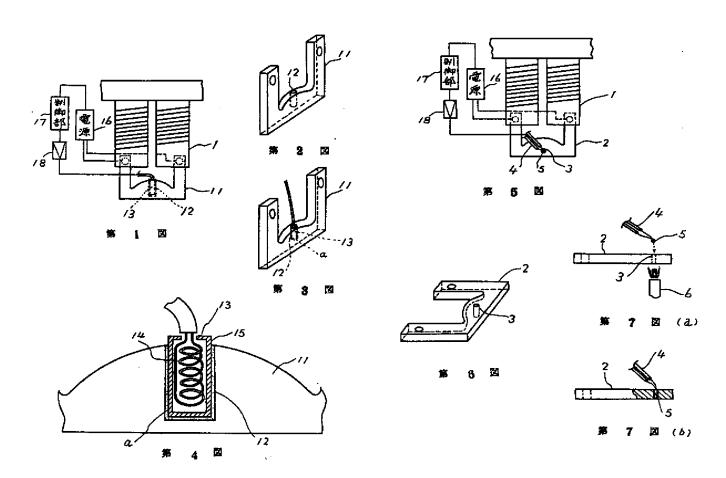
11…ヒータチップ(発熱体) 12…有底孔

13…測程抵抗体

14…白金コイル

15…セラミックスの容器 a…セラミックス系接着剤

代理人 弁理士 井 上 一 男



PAT-NO: JP363005415A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63005415 A

TITLE: METHOD AND DEVICE FOR

JOINING HEATING UNIT AND

TEMPERATURE MEASURING SENSOR

PUBN-DATE: January 11, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KOMARU, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP61148204

APPL-DATE: June 26, 1986

INT-CL (IPC): G05D023/24 , G01K007/18 ,

H05B003/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To surely join without requiring technical skill of a high order by providing a blind hole at the center parallel to the side face of a U-shaped heating unit, applying an adhesive in the blind hole, inserting a resistance body for measuring temperature and bonding it.

CONSTITUTION: A blind hole 12 is provided at the center of a U-shaped heater chip as a heating unit attached at the tip of a heating head 1 parallel to the side face of the chip. After applying an adhesive in the blind hole 12, a resistance body 13 is inserted and buried in the blind hole and left as it is. Then, as the adhesive is hardened, the resistance body 13 and the chip 11 can be joined easily. By this way, joining can be made surely without causing coming off of the joint and without requiring technical skill of a high order.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio